



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203932044 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 05

(21) 申请号 201420317903. 8

(22) 申请日 2014. 06. 13

(73) 专利权人 扬州虹扬科技发展有限公司

地址 225116 江苏省扬州市槐泗镇弘扬东路
45 号

(72) 发明人 方丁玉 陆敏琴 张杰 聂磊

(74) 专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限
公司 11212

代理人 赵秀斌

(51) Int. Cl.

H01L 23/495(2006. 01)

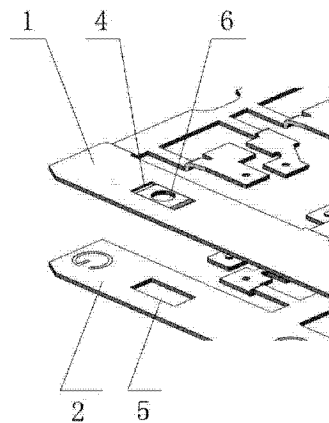
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种两片式整流桥框架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种两片式整流桥框架。包括上片框架和下片框架,所述上片框架位于所述下片框架的上方;所述上片框架上靠近所述下片框架的面为第一平面,所述第一平面上设有连接片;所述下片框架上设有与所述连接片相卡合的卡槽;所述连接片为正置的几字形。本实用新型通过在上片框架上设置几字形连接片和在下片框架上设置与所述几字形连接片相卡合的卡槽,可以在焊接前将上片框架与下片框架基本固定,焊接时连接片不容易发生偏移,使上下框架焊接更加牢固,降低了焊接不良率,提高产品的可靠性和使用寿命;同时通过定位孔的设置,可以使上下框架固定位置更加准确,操作更加简单。



1. 一种两片式整流桥框架,其特征在于:所述整流桥框架包括上片框架和下片框架,所述上片框架位于所述下片框架的上方;所述上片框架上靠近所述下片框架的面为第一平面,所述第一平面上设有连接片;所述下片框架上设有与所述连接片相卡合的卡槽;所述连接片为正置的几字形。

2. 根据权利要求1所述的整流桥框架,其特征在于:所述连接片中部与所述上片框架的第一平面相连接,且所述上片框架上与所述连接片中部位置相对应处设有定位孔,所述定位孔贯穿所述上片框架和所述连接片。

3. 根据权利要求1或2所述的整流桥框架,其特征在于:所述下片框架上设有芯片。

4. 根据权利要求3所述的整流桥框架,其特征在于:所述卡槽为长方形。

一种两片式整流桥框架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种整流桥框架,特别涉及一种两片式整流桥框架。

背景技术

[0002] 整流桥作为一种功率元器件,在各种电源设备中应用广泛。现有技术的整流桥结构,焊接时连接片容易偏移,从而与芯片接触不良,导致整流桥良率下降,成本增加,并降低了产品可靠性和使用寿命。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种两片式整流桥框架,解决了现有技术中整流桥焊接时连接片容易偏移,导致可靠性下降的问题。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种两片式整流桥框架,所述整流桥框架包括上片框架和下片框架,所述上片框架位于所述下片框架的上方;所述上片框架上靠近所述下片框架的面为第一平面,所述第一平面上设有连接片;所述下片框架上设有与所述连接片相卡合的卡槽;所述连接片为正置的几字形。

[0005] 在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

[0006] 进一步,所述连接片中部与所述上片框架的第一平面相连接,且所述上片框架上与所述连接片中部位置相对应处设有定位孔,所述定位孔贯穿所述上片框架和所述连接片。

[0007] 进一步,所述下片框架上设有芯片。

[0008] 进一步,所述卡槽为长方形。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型通过在上片框架上设置几字形连接片和在下片框架上设置与所述几字形连接片相卡合的卡槽,可以在焊接前将上片框架与下片框架基本固定,焊接时连接片不容易发生偏移,使上下框架焊接更加牢固,降低了焊接不良率,提高产品的可靠性和使用寿命;同时通过定位孔的设置,可以使上下框架固定位置更加准确,操作更加简单。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型上片框架和下片框架的结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型上片框架的侧视图;

[0012] 图3为本实用新型下片框架的侧视图;

[0013] 图4为上片框架和下片框架组合后的连接示意图;

[0014] 图5为上片框架和下片框架组合后的侧视图。

具体实施方式

[0015] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用

新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0016] 图1为本实用新型整流桥框架中上片框架和下片框架的结构示意图,图2为上片框架的侧视图,图3为下片框架的侧视图,如图1、图2和图3所示,所述上片框架1位于所述下片框架2的上方;所述上片框架1上靠近所述下片框架2的面为第一平面3,所述第一平面3上设有正置的几字形连接片4;所述下片框架2上设有与所述几字形连接片4相卡合的长方形卡槽5,如图4所示,为所述上片框架1和下片框架2组合后的连接示意图,如图5所示,为所述上片框架1和下片框架2组合后的侧视图。本实施例中,所述几字形连接片4中部与所述上片框架的第一平面3相连接,且所述上片框架1上与所述连接片4中部位置相对应处设有定位孔6,所述定位孔贯穿6所述上片框架1和所述几字形连接片4。

[0017] 本实施例的整流桥框架使用中,首先芯片设置在下片框架2上,然后将上片框架1的几字形连接片卡和在在下片框架2的卡槽5,即可使上片框架1和下片框架2的位置保持稳定。

[0018] 本实用新型通过在上片框架上设置几字形连接片和在下片框架上设置与所述几字形连接片相卡合的卡槽,可以在焊接前将上片框架与下片框架基本固定,焊接时连接片不容易发生偏移,使上下框架焊接更加牢固,降低了焊接不良率,提高产品的可靠性和使用寿命;同时通过定位孔的设置,可以使上下框架固定位置更加准确,操作更加简单。

[0019] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

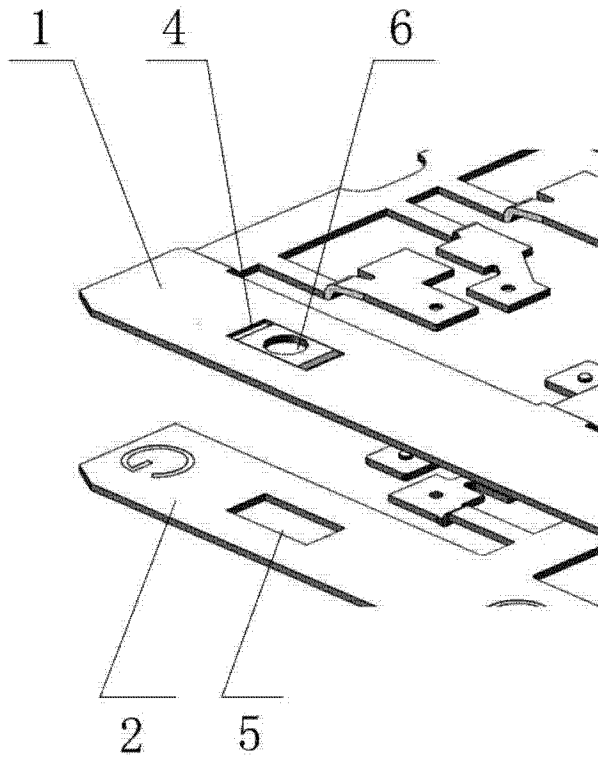


图 1

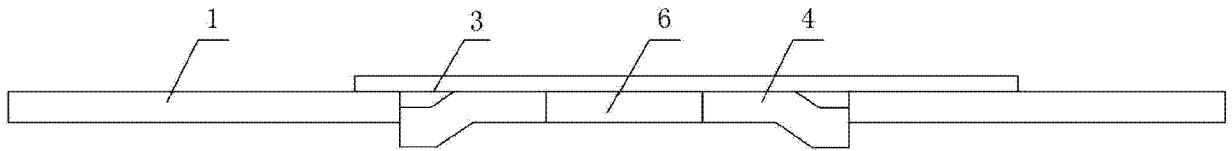


图 2

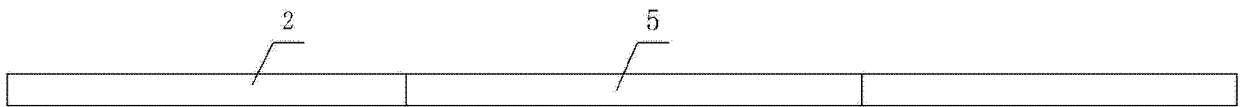


图 3

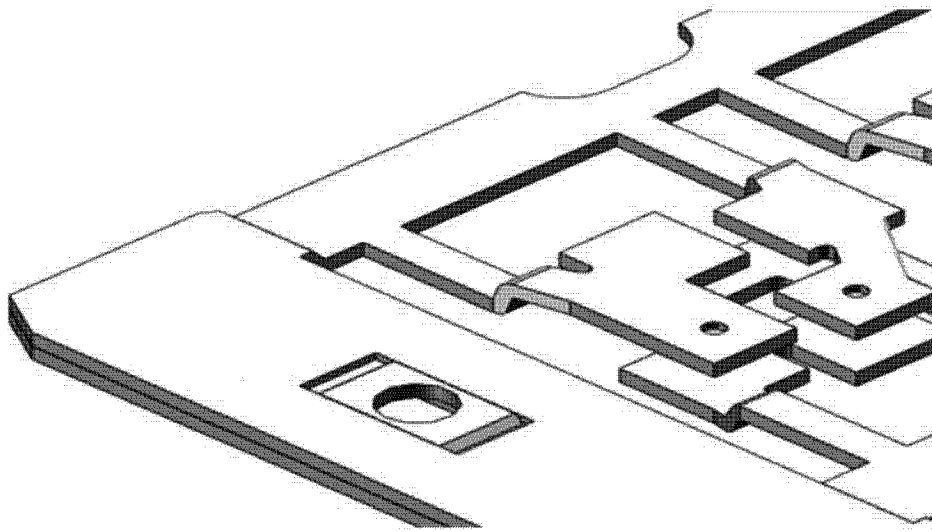


图 4

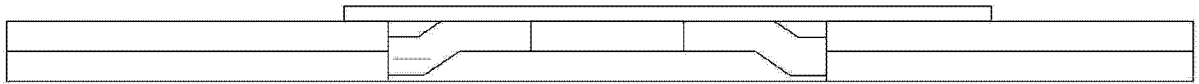


图 5